

证券代码：688469

证券简称：芯联集成

芯联集成电路制造股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-009

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	UBS中国等多家机构
时间	2024年09月06日 9:30-11:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、总经理 赵奇 财务负责人、董事会秘书 王伟
投资者关系活动主要内容介绍	<p>现场交流与问答：</p> <p>1、公司如何展望中国功率半导体公司在未来2-3年的成长潜力？</p> <p>回复：中国功率半导体公司在未来2-3年内有望展现出显著的成长潜力。这一预测基于多个因素的综合考量，包括行业发展趋势、技术创新、政策支持以及市场需求等。</p> <p>首先，从行业发展趋势来看，功率半导体作为电子产业链中核心的器件之一，其应用领域广泛，包括但不限于智能电网、新能源汽车、光伏与储能等。随着这些领域的快速发展，对功率半导体的需求将持续增长，为行业带来广阔的市场空间。特别是在新能源汽车领域，功率半导体作为汽车电子的核心，是新能源汽车中成本仅次于电池的第二大核心零部件。新能源汽车市场的增长和智能化技术的快速发展，必将带来功率半导体和模拟IC产品的快速增长。</p> <p>技术创新是推动功率半导体行业发展的关键因素。随着材料科学的进步，如碳化硅（SiC）和氮化镓（GaN）等新型半导体材料的商业化应用，功率半导体器件的性能将得到飞跃。这些新材料不仅耐高温、耐高压，而且具</p>

备更高的能量转换效率和更低的能耗，为电力电子系统的小型化、轻量化、高效化提供了无限可能。未来，功率半导体行业将持续深耕技术前沿，以创新驱动发展，不断解锁新应用，推动产业升级。

政策支持也是推动功率半导体行业发展的重要因素。国家对功率半导体行业的发展给予了高度重视，出台了一系列政策鼓励技术创新和产业发展。这些政策为功率半导体行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。

市场需求方面，随着全球绿色能源转型的大背景，功率半导体成为了实现能源高效利用和清洁能源替代的关键技术之一。在智能电网、新能源汽车、风力发电、太阳能光伏等环节中，功率半导体都发挥着至关重要的作用。随着可再生能源比例不断提升，对功率半导体器件的需求也将持续增长。未来，功率半导体将更加注重与绿色能源技术的深度融合，为构建清洁、低碳、安全、高效的能源体系贡献力量。

综上所述，中国功率半导体公司在未来2-3年内有望迎来显著的成长潜力，受益于行业发展趋势、技术创新、政策支持以及市场需求等多重因素的共同作用。

2、怎么看待产能过剩情况？公司的产能利用率，现在和展望？

回复：目前功率产能过剩主要集中在低端市场。随着技术进步和市场需求的变化，未来功率器件市场将呈现高端产能紧张、低端产能过剩的局面。

上半年，随着市场需求的复苏，伴随芯片国产化的大趋势，公司8英寸硅基产品线产能利用率饱满；SiC晶圆产线、12英寸硅基晶圆产线及对应的模组产线产能及产能利用率显著提升。

为了应对市场的变化，公司在功率方面的战略规划包括：①在低压功率市场方面，坚定地服务好工艺代工的设计客户，提供差异化的特色平台；②在高压功率市场方面，目前已经呈现出高度集中的态势，公司将主要提供系统代工（设计+晶圆+模组），贴近应用终端，快速迭代，并利用已有的规模优势、客户优势、技术优势进一步扩大市场份额；③对于新增需求，例如AI服务器对高功率器件提出的新需求，公司将增加GaN工艺能力，来满足新应用的需求。

综上所述，功率器件市场在未来将面临高端产能紧张、低端产能过剩的局面。为了抓住市场机遇，公司将同时做好工艺代工服务和系统代工服务两条路线，努力成为中国功率器件市场的领导者。

3、AI无疑是目前行业发展最重要的推动力之一。对中国的功率半导体公司而言，AI会带来哪些机会？以及公司如何抓住这波机会？

回复:伴随终端厂商库存去化的逐步完成，叠加AI大模型赋能智能手机和PC的加速迭代升级，2024年上半年消费电子需求回暖，下半年供应链厂商有望延续复苏态势。

据工信部统计，2024年1-5月，中国手机产量6.2亿台，同比增长10.6%，其中智能手机产量4.6亿台，同比增长12%。受益于AI大模型的赋能，智能手机及PC将开启新一轮创新周期。终端产品的升级换代或将带动消费电子领域MEMS传感器芯片、功率器件及模拟IC等的整体增长，同时AI手机及AI PC搭载大模型带来大量计算、高能耗需求，有望带动电源管理类芯片形成新场景下的增量需求。

公司在AI人工智能领域主要覆盖AI手机、AI电脑和服务器市场。在AI数据中心应用上，公司携手芯片设计合作伙伴在电源管理芯片获得重大定点。公司应用于AI服务器多相电源的BCD工艺产品，成功量产；覆盖AI服务器电源芯片的低压大电流电源管理工艺平台通过集成DrMOS实现了更高密度的电源管理方案，满足大电流开关；智能高边开关平台，应用于汽车高边开关的智能控制保护，实现控制与功率器件的结合，能提供更好的电路保护和故障检测功能。

随着AI领域的技术布局和市场开拓，公司将继续推进智能传感芯片、高效电源管理芯片等产品在汽车智能化和机器人领域的应用和市场渗透。

4、公司如何看待国内功率半导体的格局，会在2-3年慢慢改善吗？从长期来看，中国是否也会有像英飞凌等一样的功率半导体公司脱颖而出？

回复:随着碳化硅的加速上车，汽车电子巨头都在加大范围扩产，其中以功率半导体巨头英飞凌扩产动作最多。与此同时，本土SiC功率器件品牌正在快速成长，伴随6英寸工艺的逐渐成熟和各大品牌产能的逐步释放，本土品牌借助价格优势迅速占领中低端市场将是必然之势，少数头部品牌则会发力冲击中高端市场，缩小和国际品牌的差距。伴随芯片国产化的大趋势，未来我国功率半导体企业也必将占据更多市场份额。另外，芯联集成IGBT在五年间迭代了四代，目前，最新一代的产品与英飞凌的EDT3在同一水平线上。

在碳化硅业务，上半年芯联集成继续保持先发优势，应用于汽车主驱的车规级SiC MOSFET产品出货量亚洲第一。①在客户方面，持续拓展车载领域和工控领域国内外OEM和Tier1客户，上半年已在多家客户实现量产，更多客户处于定点+产品导入阶段。②在车规级产品工艺方面，SiC工艺平台实现了650V到1700V系列的全面布局。在技术迭代方面，完成了平面型SiC MOSFET

	<p>产品两年迭代3代并实现量产；同时储备了沟槽型SiC MOSFET产品的技术。③</p> <p>在产线建设方面，公司8英寸碳化硅产线于2024年4月完成工程批下线，实现中国第一，全球第二通线。上半年，公司SiC MOSFET晶圆产品收入比上年同期增长超300%、环比增长超50%。2024年，公司碳化硅产品预计实现10亿元以上收入。公司目前SiC技术储备丰富，不断导入国内外头部客户，帮助公司向未来占据全球30%市场份额的目标稳步前进。</p> <p>从长期来看，依托国内巨大的市场需求和不断创新的要求，模拟类电路方面会有优秀的国内企业崛起。</p> <p>5、公司在BCD等模拟IC领域的有什么具体的规划？</p> <p>回复：公司立足于车规级BCD平台，是国内在该领域布局最完整的企业之一。公司的BCD工艺技术研发已达到国际领先水平。</p> <p>在模拟IC芯片领域，公司聚焦于国内稀缺的高性能、高功率、高可靠性BCD技术方向。上半年公司新发布四个车规级平台，其中数模混合嵌入式控制芯片制造平台填补了国内驱动+控制集成化芯片技术的空白；高边智能开关芯片制造平台、高压BCD 120V平台对应的技术为国内该领域的稀缺技术；高压SOI BCD平台对应的技术位于国内领先水平。同时，公司携手多个芯片设计客户，获得国内多个车企和Tier1项目定点。</p> <p>未来，公司将继续坚持技术+市场双轮驱动的策略，持续进行市场的开拓和技术的迭代，实现技术赶超，扩大市场份额，并积极进入海外市场；进一步重点发展高压模拟集成芯片新工艺技术平台，为广大产品公司打造有竞争力的国产模拟集成芯片提供最优质的代工制造平台。同时，公司还将不断拓展新产品线，计划于下半年推出高可靠性、高性能专用MCU平台；也将不断拓宽业务领域，全面布局高增长的AI高速服务器领域。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年09月06日